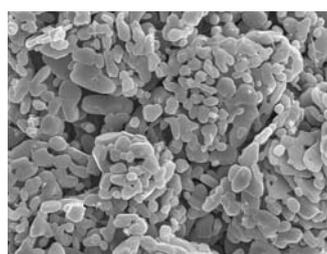


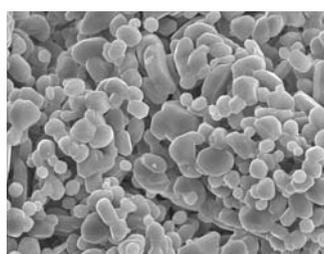
低ソーダアルミナ

低ソーダアルミナは、化学的安定性、電気絶縁性、耐熱性、熱伝導性、硬度、機械的強度等に優れており、電子部品、スパークプラグ、機械部品ならびに、切削工具等のセラミックス原料

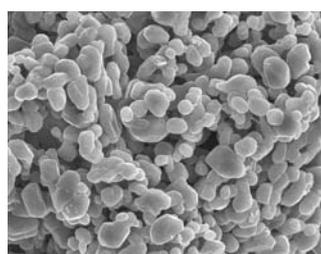
として広く使用されています。各用途に合わせて、焼成収縮率、焼結特性等を管理しています。



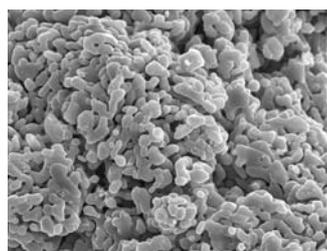
LS-11 10μm



LS-12 10μm



LS-13 10μm



LS-20 10μm



LS-22 10μm



LS-21 10μm

標準品質 (標準粒品)

品名	SLS-13	LS-11	LS-12	LS-13	LS-20	LS-22	LS-21
LOI (%)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
Na ₂ O (%)	0.04	0.05	0.03	0.03	0.08	0.07	0.07
SiO ₂ (%)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.02	0.02	0.02
Fe ₂ O ₃ (%)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
Al ₂ O ₃ (%)	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
平均粒径 (μm)	105	55	55	55	20~40	20~40	20~40
α粒子径 (μm)	—	1~2	1~3	2~4	2~3	2~3	3~5
BET比表面積 (m ² /g)	—	1.5	1.2	0.9	1.5	1.1	0.6
成形密度 (g/cm ³) *	—	2.03	2.10	2.12	2.04	2.10	2.26
見掛密度 (g/cm ³) *	—	3.79	3.81	3.78	3.81	3.81	3.77
焼結かさ密度 (g/cm ³) *	—	3.79	3.80	3.78	3.81	3.81	3.78
割掛率 *	—	1.24	1.23	1.22	1.23	1.22	1.19
線収縮率 (%) *	—	19.2	18.7	17.7	19.0	18.0	15.9

*LS-11、LS-12、LS-13は粉砕後フラックス4%添加、プレス圧力：49.03MPa(500kgf/cm²)、1590℃×3hr焼成

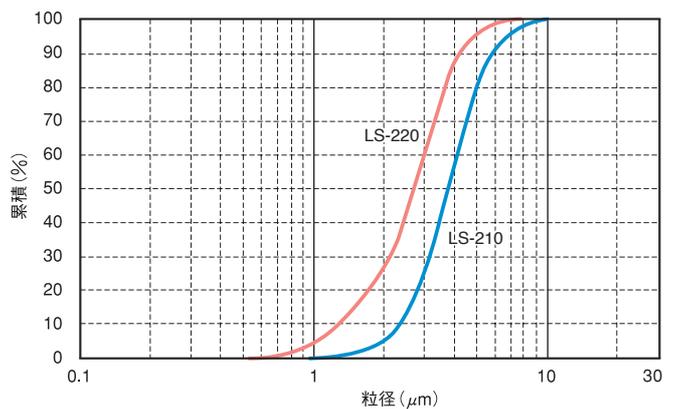
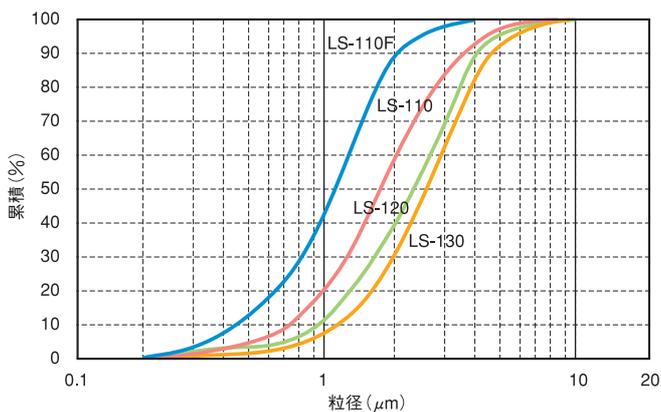
*LS-20、LS-22、LS-21は粉砕後フラックス4%添加、プレス圧力：49.03MPa(500kgf/cm²)、1640℃×3hr焼成

標準品質 (微粒品)

品名	LS-110	LS-120	LS-130	LS-110F	LS-220	LS-210
LOI(%)	0.02	0.02	0.05	0.08	0.03	0.01
Na ₂ O(%)	0.05	0.04	0.03	0.05	0.07	0.08
SiO ₂ (%)	0.07	0.07	0.07	0.09	0.02	0.02
Fe ₂ O ₃ (%)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
Al ₂ O ₃ (%)	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
平均粒径(μm)	1.7	2.1	2.2	1.1	2.7	2.9
α粒子径(μm)	1~2	1~3	2~4	1~2	2~3	3~5
BET比表面積(m ² /g)	1.9	1.4	1.4	3.2	1.6	0.9
加圧かさ密度(g/cm ³)*	2.22	2.27	2.31	2.29	2.22	2.32
成形密度(g/cm ³ **)	2.13	2.20	2.23	2.33	2.17	2.30
見掛密度(g/cm ³ **)	3.78	3.79	3.77	3.88	3.80	3.76
焼結かさ密度(g/cm ³ **)	3.78	3.79	3.78	3.89	3.81	3.77
割掛率**	1.22	1.21	1.20	1.19	1.21	1.18
線収縮率(%)	18.0	17.2	16.7	15.7	17.5	15.3

*プレス圧力:98.07MPa(1000kgf/cm²) **フラックス4%添加、プレス圧力:49.03MPa(500kgf/cm²)、1640℃×3hr焼成

粒度分布



推奨用途

- (1) スパークプラグ
- (2) 電子部品 (IC基盤、コンデンサー)
- (3) 半導体製造装置部材
- (4) 理化学機器
- (5) 機械部品
- (6) 特殊耐火物
- (7) 触媒担体

荷姿

フレコンバッグ (500kg、1000kg)
紙袋 (25kg)

